

2021年3月期 決算説明資料

2021年5月14日



内外テック株式会社
JASDAQ3374

2021年3月期 連結業績

代表取締役社長 岩井田 克郎

業績

- **2021年3月期は、予想（2020年7月10日公表）を上回る増収増益を達成**
 - ⇒ ロジック・メモリー投資の増加による好調。
テレワークやリモートワーク等によるデータトラフィック量の急増によりデータセンター需要が拡大、5G通信の世界的な普及に向けた投資も順調に推移。
- **2022年3月期は、データセンター需要のさらなる拡大のほか、民生電子機器や車載関連の生産復調から、引き続き増収増益を見込む**

トピックス

- **宮城県大衡村に2020年9月宮城物流センター新棟竣工・移転**
 - ⇒ 中長期的な半導体需要の拡大に向けた物流体制を強化
- **協力体制強化及び事業規模拡大のため、入江工研株式会社と資本業務提携を締結**

予想を上回る大幅な増収増益に

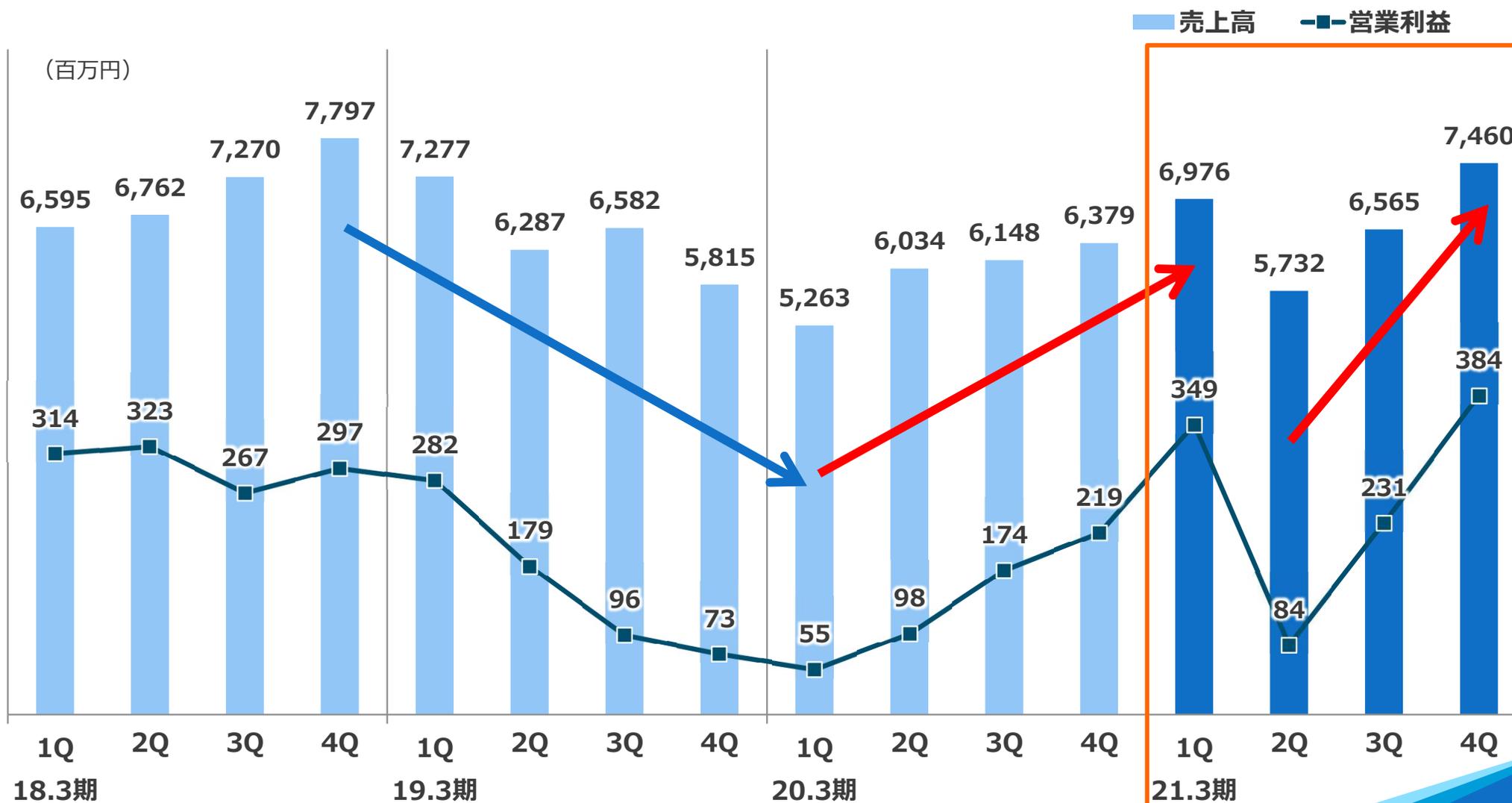
(百万円、%)

	2020.3期			2021.3期			
	実績	前期比	構成比	実績	前期比	構成比	予想 (7月10日公表)
売上高	23,825	△ 8.2	100.0	26,734	12.2	100.0	25,500
売上原価	21,187	△ 8.5	88.9	23,558	11.2	88.1	-
販管費	2,090	△ 4.3	8.8	2,126	1.7	8.0	-
営業利益	547	△13.3	2.3	1,049	91.5	3.9	867
経常利益	533	△14.1	2.2	1,037	94.3	3.9	850
親会社株主に帰属する 当期純利益	333	△18.5	1.4	743	2.2倍	2.8	550

- 売上高は、テレワーク等によるデータトラフィック量増加等を背景に前期からの堅調なロジック投資の更なる増加に加え、メモリーの回復による好調。
- 販管費は、新型コロナウイルス感染症対策や物流センター移転に係る一時的な費用が発生するも、効率化の推進によりほぼ前期並み。

2Qは一時的に停滞も、3Q以降再拡大傾向

- 2Qは新型コロナウイルス感染症拡大の不透明感から1Qに2Q分の上乗せ受注があったため、一時的に減収減益になるものの3Q以降は需要再拡大で上昇基調続く

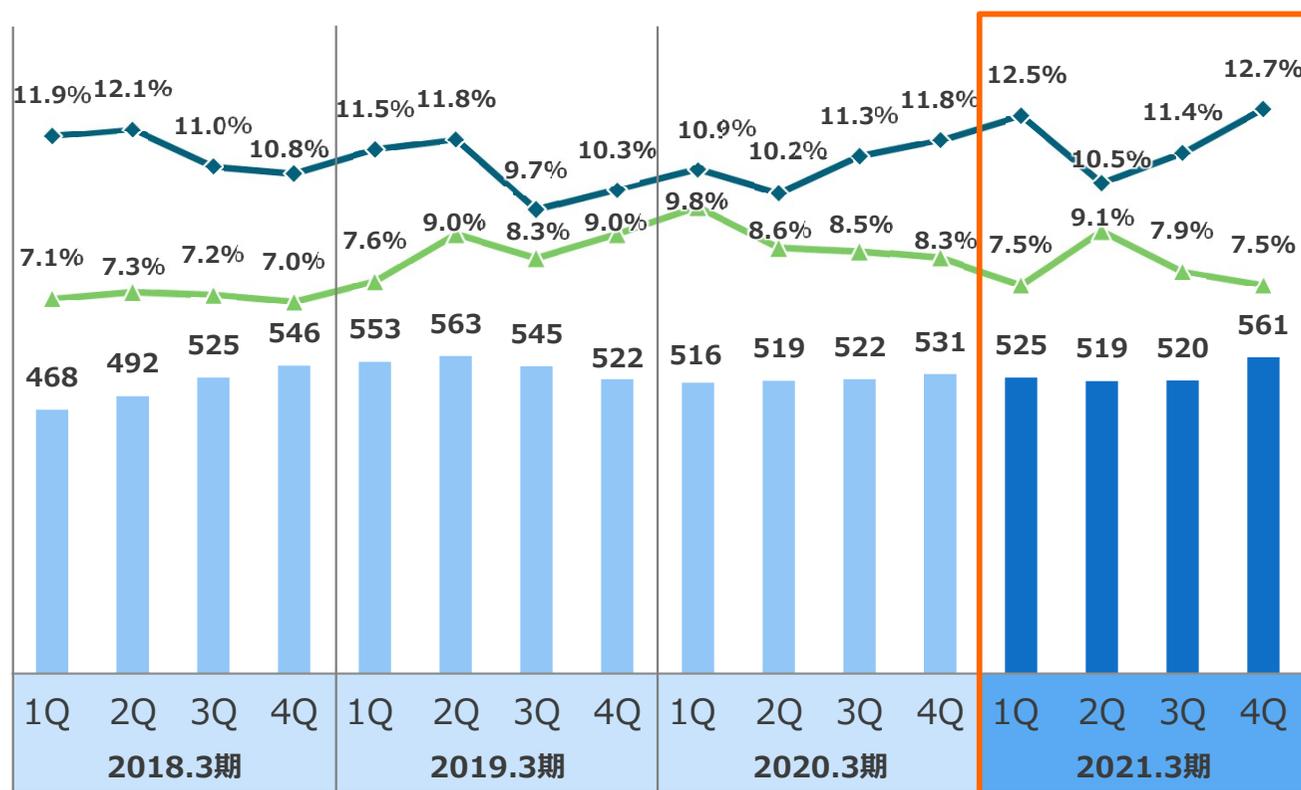


売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は、2Qに低下となるも3Q以降回復傾向 販管費は、一定水準で推移

(百万円)

■ 販管費 ◆ 売上総利益率 ▲ 販管費率



売上総利益率

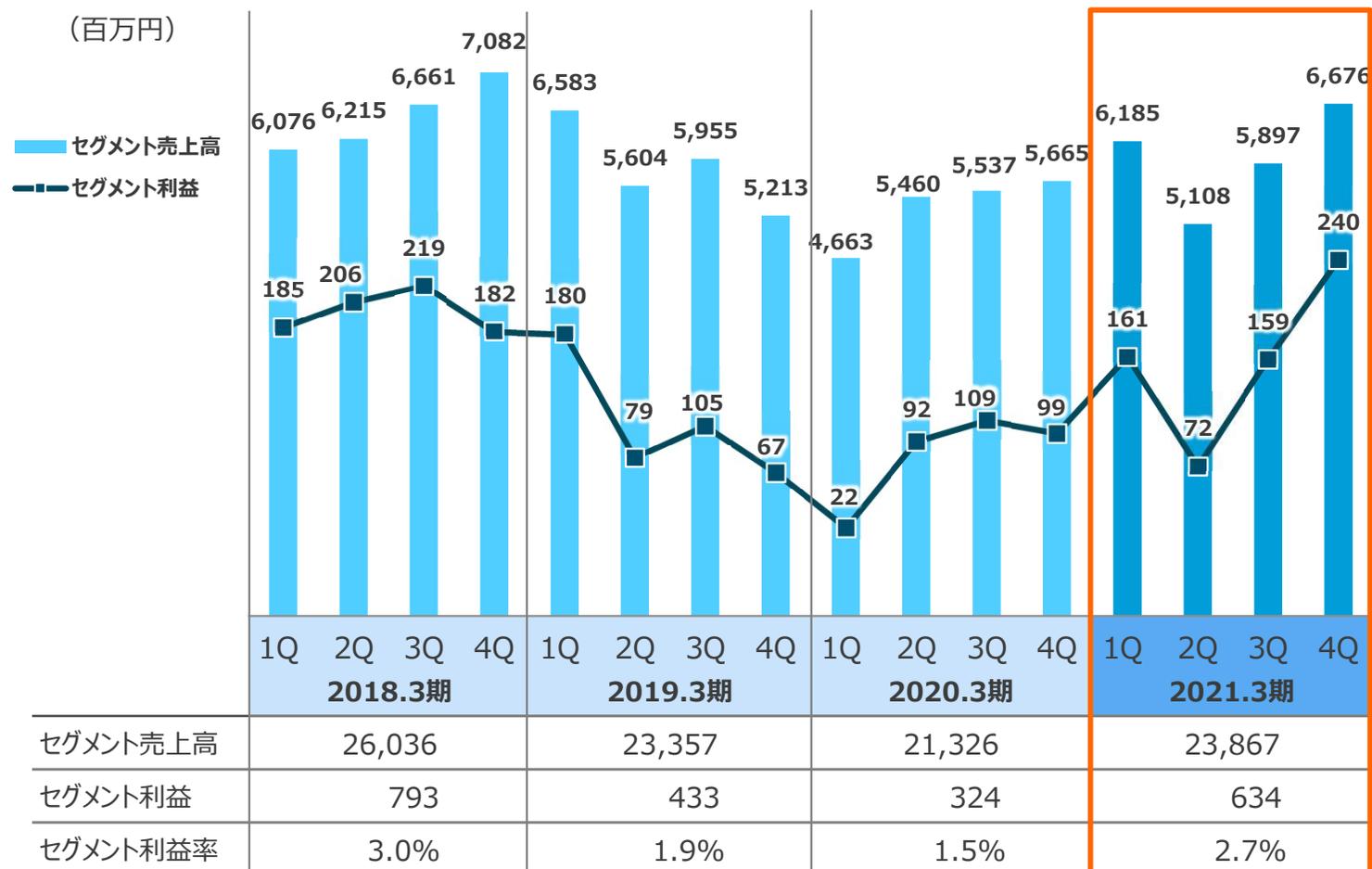
- 増収効果により高水準維持
- 2Qをボトムに回復傾向
- 4Qは仕入先からの販売奨励金によりさらに上昇

販管費・販管費率

- 販管費は、新型コロナウイルス感染症対策や物流センター移転等の一時的費用があるも、効率化の推進により一定水準で推移。
- 増収効果により販管費率低下傾向。

売上総利益率	11.4%	10.9%	11.1%	11.9%
販管費率	7.2%	8.4%	8.8%	8.0%
販管費 (百万円)	2,033	2,184	2,090	2,126

3期振りに増収増益に セグメント売上高・利益ともに予想を上回り、拡大傾向



セグメント売上高 23,867百万円
(前期比 11.9% )

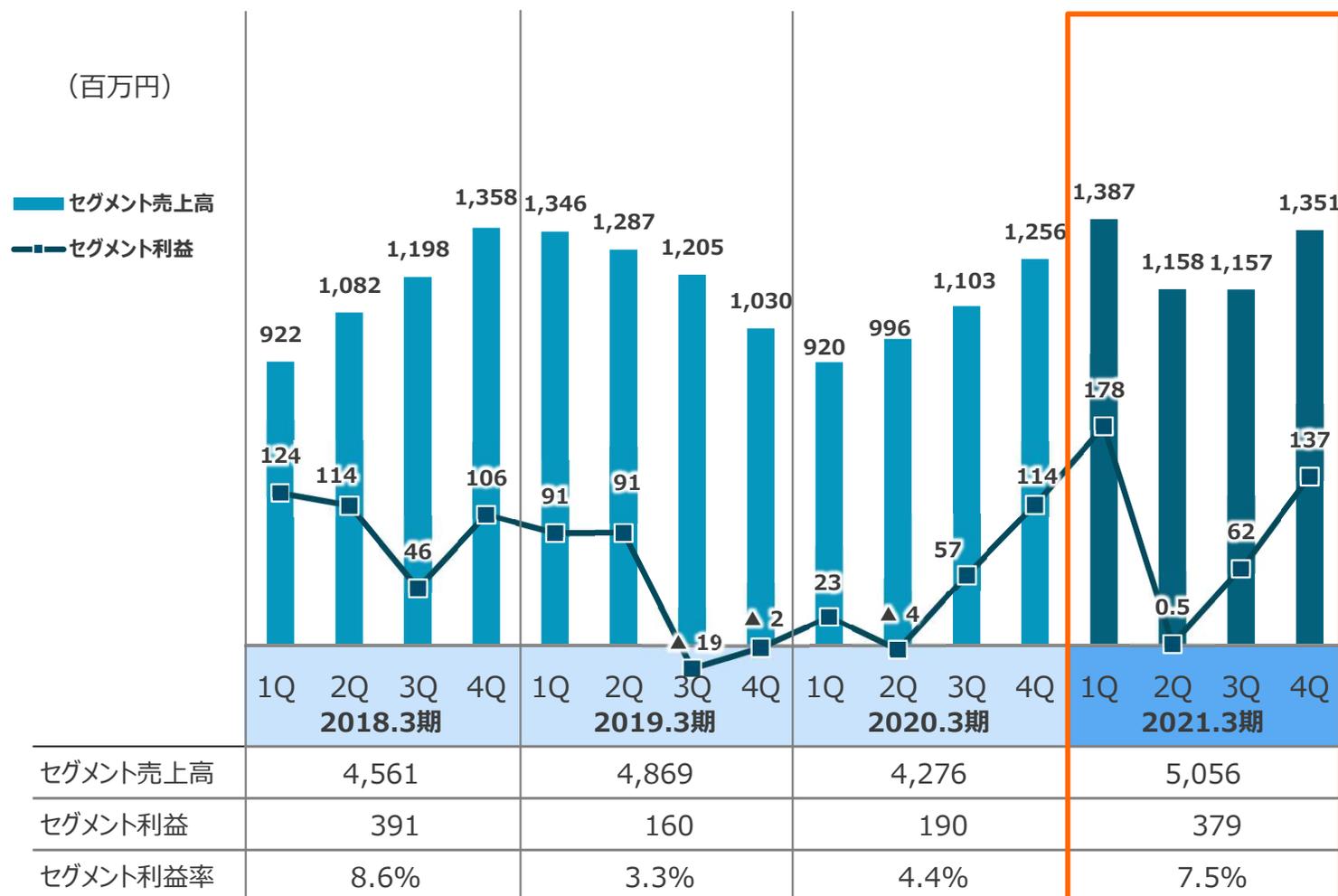
- 新型コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーンにおける商材の納期遅れを懸念し1Qに受注が集中。2Qはその影響を受け調整局面となった。
- 年間を通じては、テレワークやリモートワーク等によるトラフィック量増加を背景にデータセンター投資の活発化を受けて、ロジック・メモリ投資ともに大幅増加。

セグメント利益 634百万円
(前期比 95.3% )

- 売上増加に伴い増益。
- 仕入先からの販売奨励金が4Qに寄与。

(注) 売上高は連結調整前

セグメント売上高は過去最高により増収増益に



セグメント売上高 5,056百万円
(前期比 18.2% )

- 2Q・3Qに一服感があるも、半導体主要メーカーの投資再拡大を受けて増収。

セグメント利益 379百万円
(前期比 99.1% )

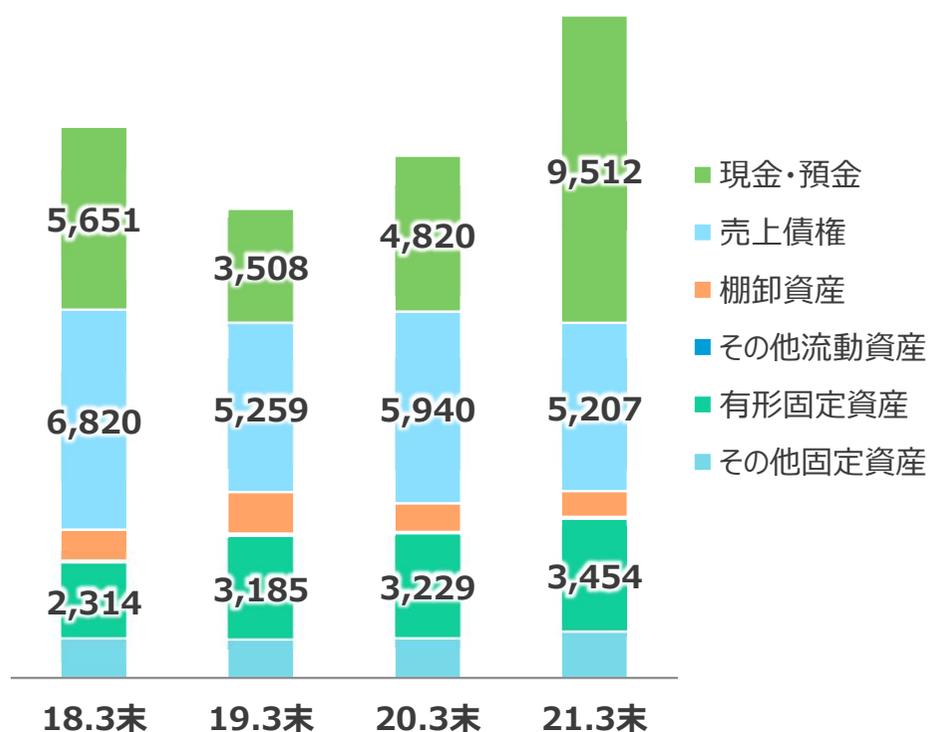
- 2Q・3Qは、売上減少に加え回復に備えた製造人員維持により、1Qに比べ利益大幅減。
- 通期では、売上増加及び生産効率改善により、大幅増益。

(注) 売上高は連結調整前

貸借対照表

◆ 資産

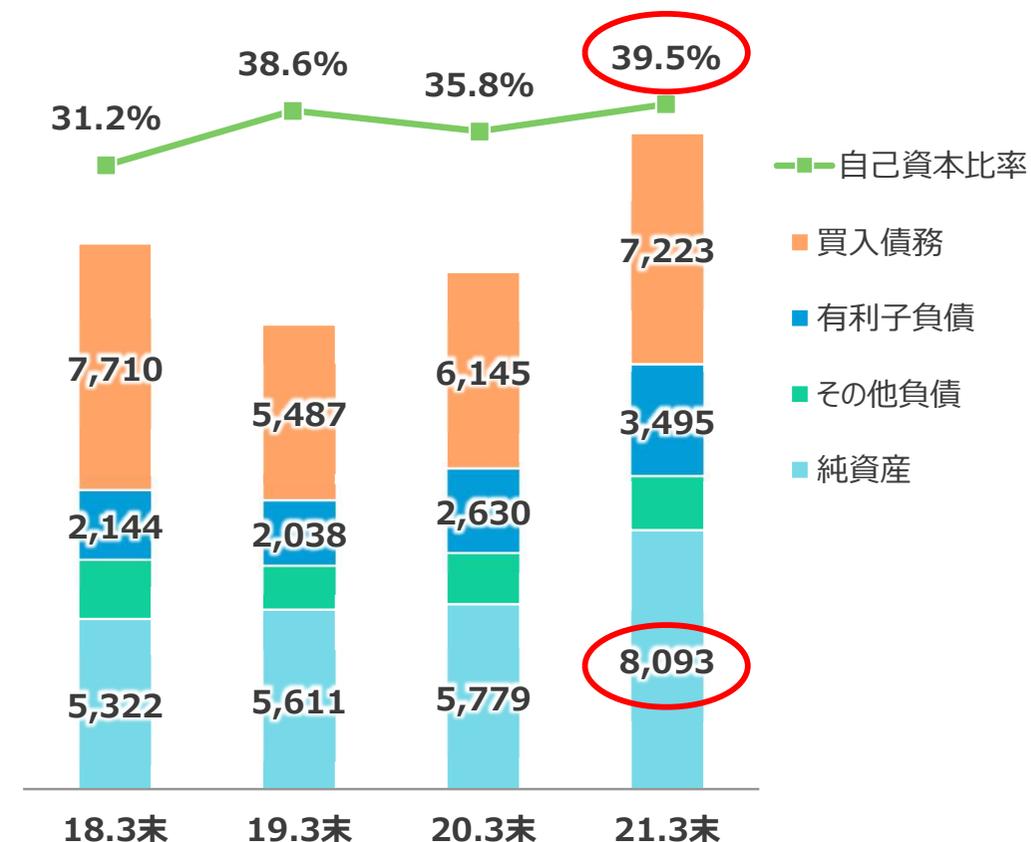
(百万円)



- エクイティ・ファイナンス実施等により現預金は46億92百万円増加
- 売上債権回収サイトの短縮により売上債権減少
- 宮城物流センター新棟完成により有形固定資産増加

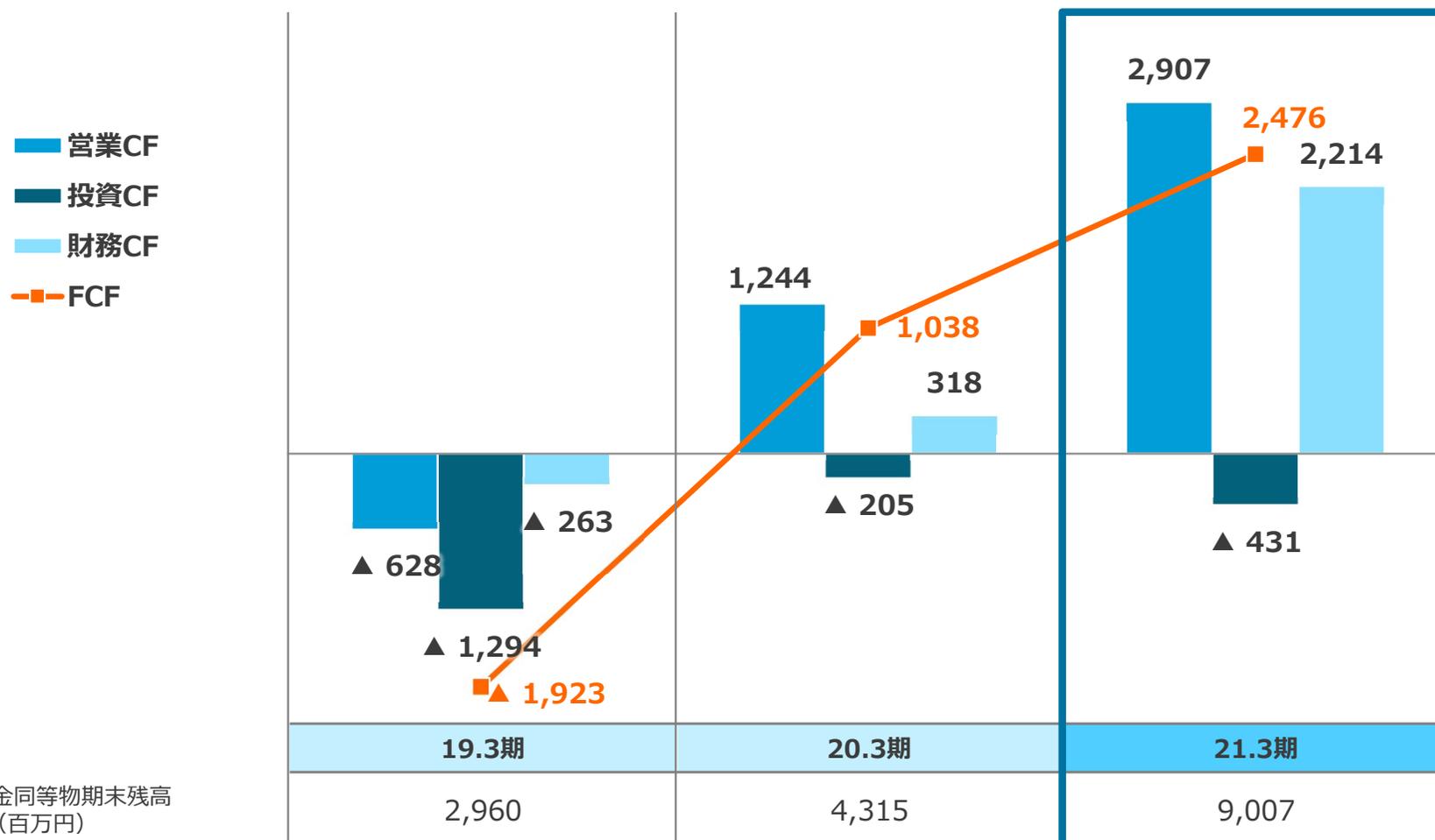
◆ 負債・純資産

(百万円)



- 利益の積み上げ、エクイティ・ファイナンス実施により純資産は80億円に増加し、自己資本比率は39.5%に向上
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴うリスク回避のため借入を増加し、有利子負債が8億64百万円増加

業績好調による利益増加を受けてフリーキャッシュフロー大幅増加 現金及び現金同等物残高は、90億円に



- 業績好調、売上債権・仕入債務のバランス改善から、営業キャッシュフローは29億7百万円に拡大
- エクイティ・ファイナンスによる資金調達に加え、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うリスク回避のため借入増加により、財務キャッシュフローは22億14百万円に拡大

トピックス：受託製造事業の強化に向けた取り組み

◆ 宮城物流センター（宮城県大衡村）竣工

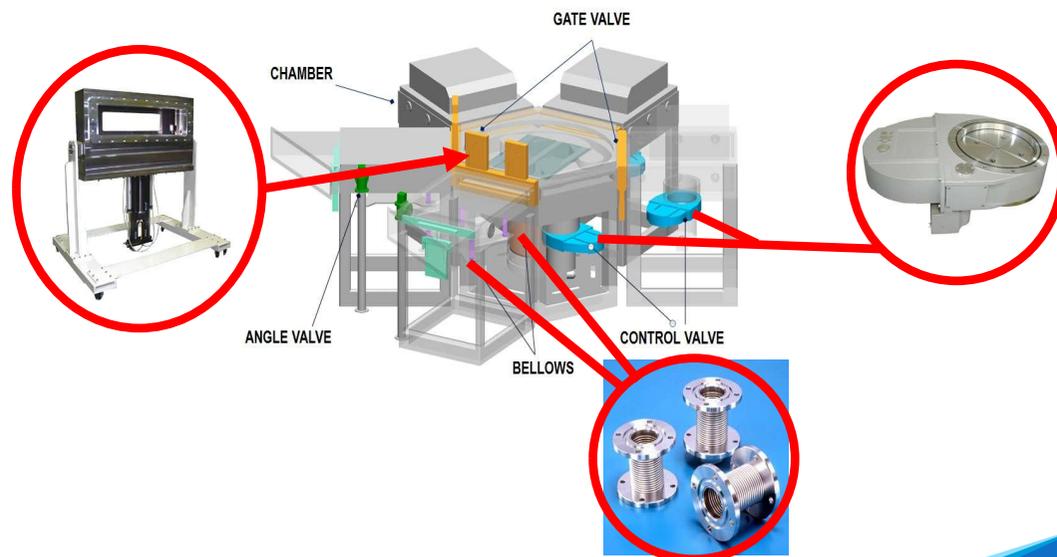
- 中長期的な半導体需要の拡大に備えた物流戦略の一環として、2020年9月に新棟竣工
- 従業員の安全への考慮やより良い職場環境を提供し作業効率向上を目指した物流センター
 - ・ 倉庫面積拡大
(1,465㎡から2,125㎡と約1.5拡張)
 - ・ 保管面積拡張による作業効率の向上



◆ 入江工研株式会社との資本業務提携

代表者	代表取締役社長 入江則裕
設立	昭和41年5月24日
主製品と強み	真空環境で使用するベローズや大型ゲートバルブの中堅メーカーです。特に大型ゲートバルブは、世界三大メーカーの一角として真空業界のリーダー的役割を担っております。
シナジー効果	当社グループの商社機能と受託製造機能に加えて真空機器メーカーの入江工研と協業することにより真空機器開発No.1を目指します。

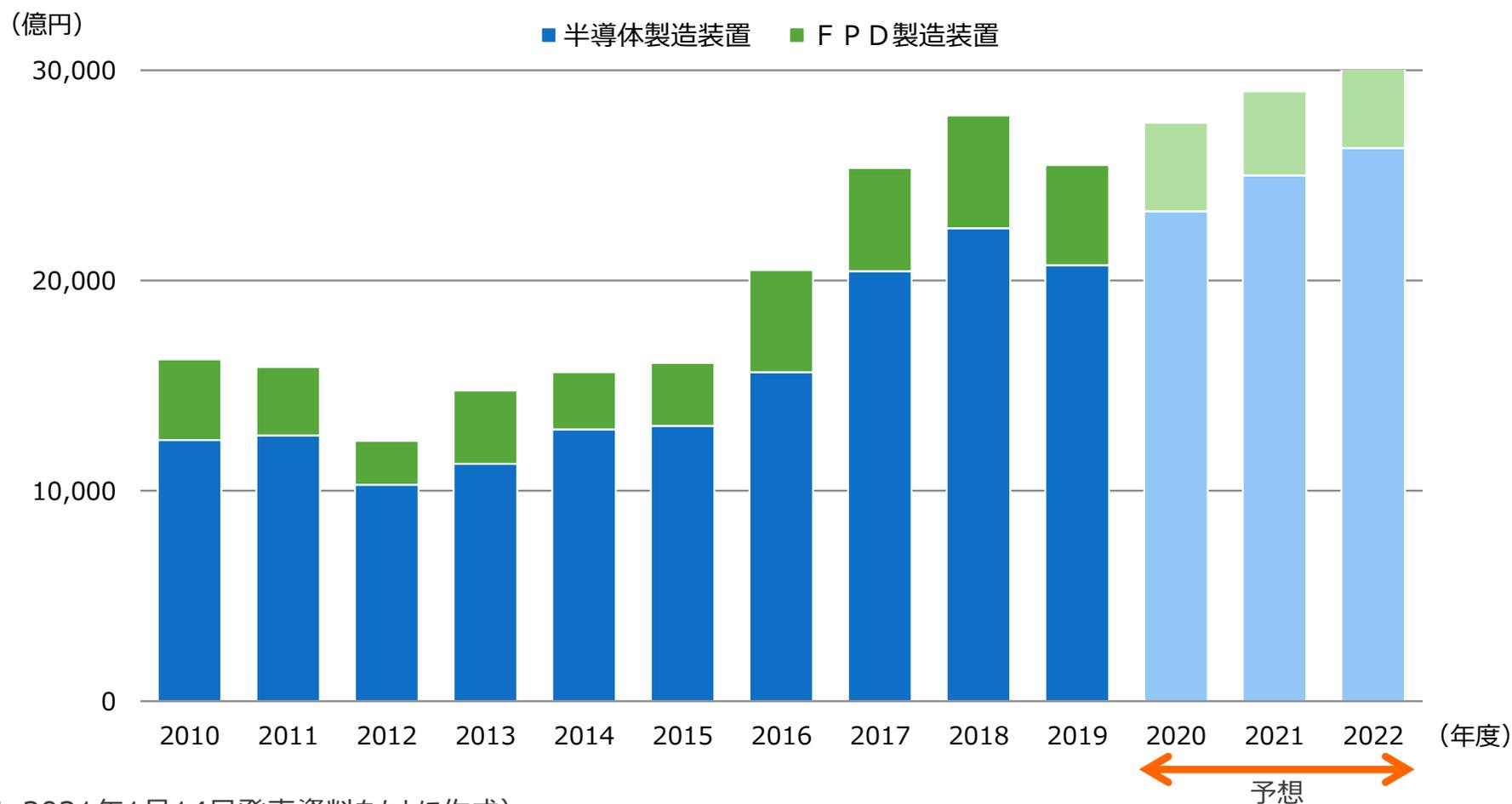
半導体・FPDなどの製造装置(真空チャンバー)



2022年3月期 連結業績予想

日本製半導体製造装置販売高は、引き続き拡大傾向を見込む 2022年度は、SEAJ統計開始以来の最高記録を見込む

半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



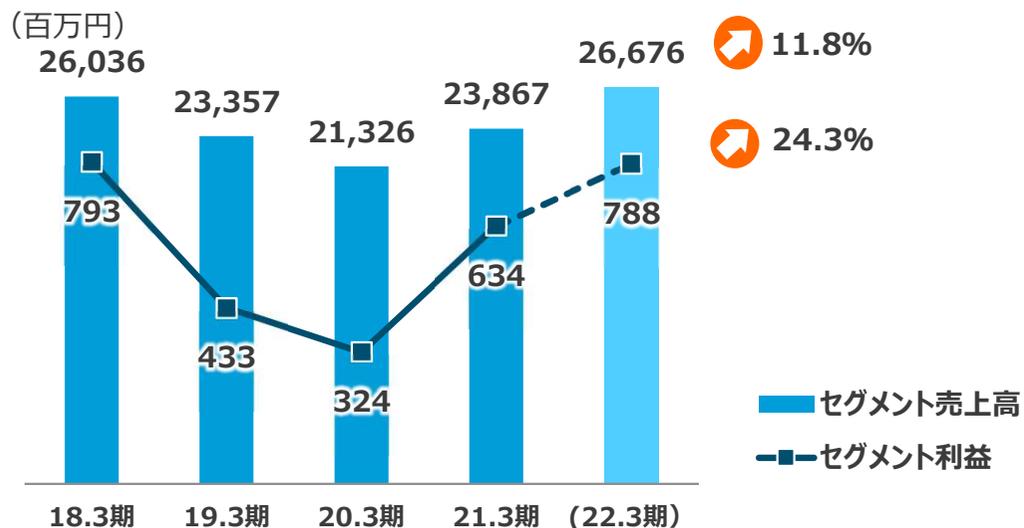
(SEAJ 2021年1月14日発表資料をもとに作成)

5Gの普及やデータセンター向け等半導体の需要活況 大幅増収増益を見込む

(百万円、%)

	2021.3期			2022.3期				
	実績	前期比	構成比	予想	前期比	構成比	2Q累計	前年同期比
売上高	26,734	12.2	100.0	30,000	12.2	100.0	14,760	16.1
営業利益	1,049	91.5	3.9	1,400	33.4	4.7	637	46.8
経常利益	1,037	94.3	3.9	1,380	33.0	4.6	630	47.9
親会社株主に帰属する 当期純利益	743	2.2倍	2.8	930	25.2	3.1	425	55.0

◆ 販売事業



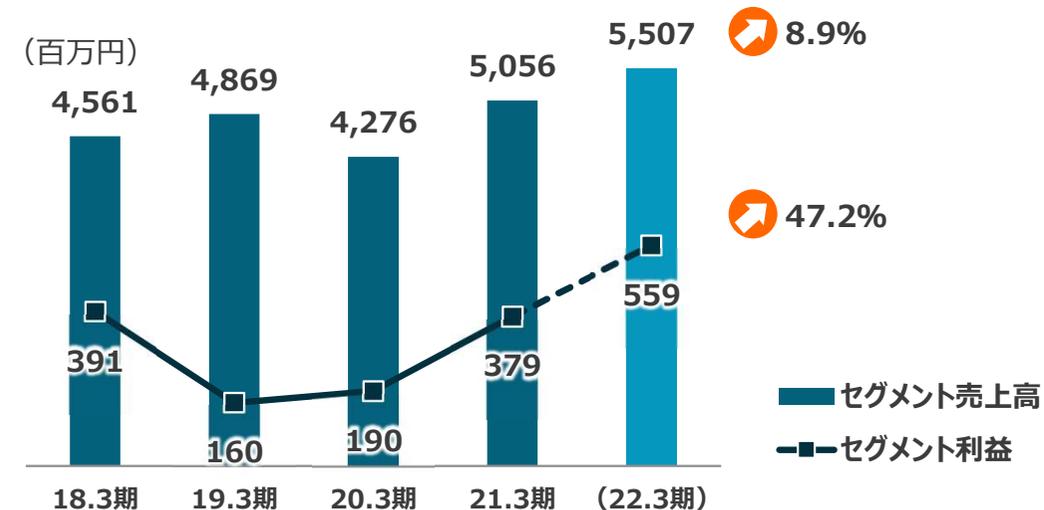
セグメント売上高

- 先期から続く半導体需要増加を背景に、ロジック・メモリ投資拡大を見込み、増収を予想。

セグメント利益

- 売上増加及び業務効率化による増益を見込む。

◆ 受託製造事業



セグメント売上高

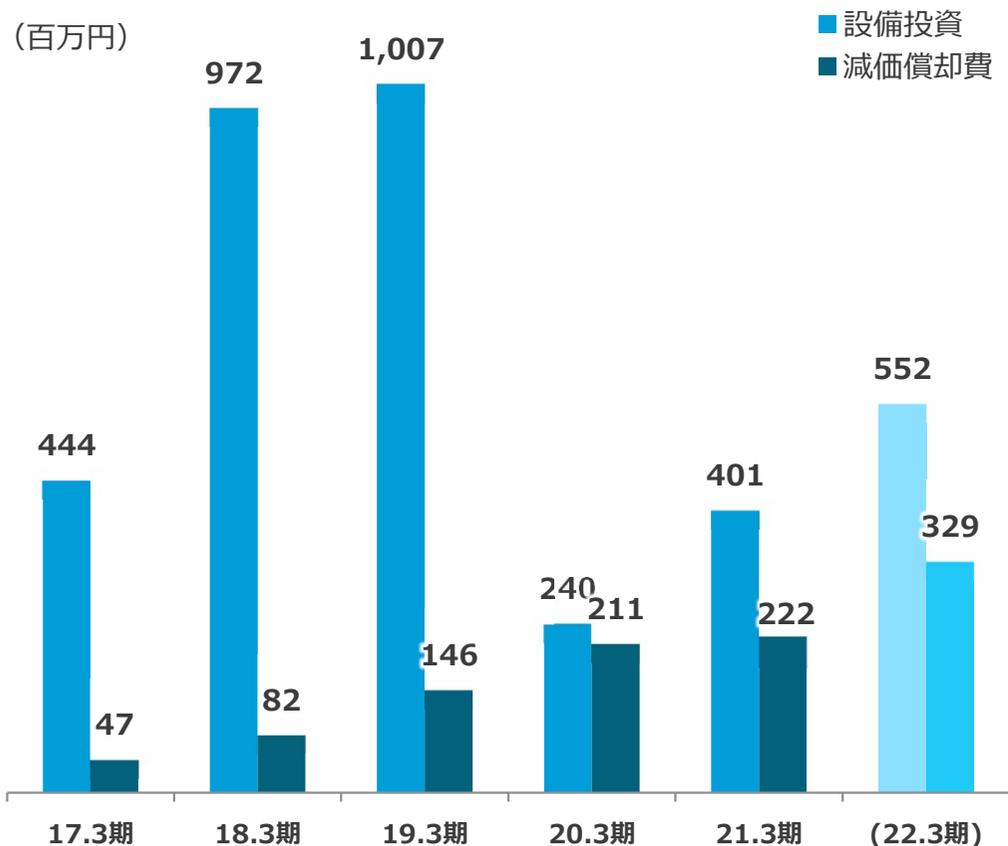
- 主要顧客からの堅調な受注により増加傾向。

セグメント利益

- 損益分岐点操業度の改善や合理化による収益改善を見込む。

(注) 売上高は連結調整前

今後の成長を見据え生産体制拡大のため再投資

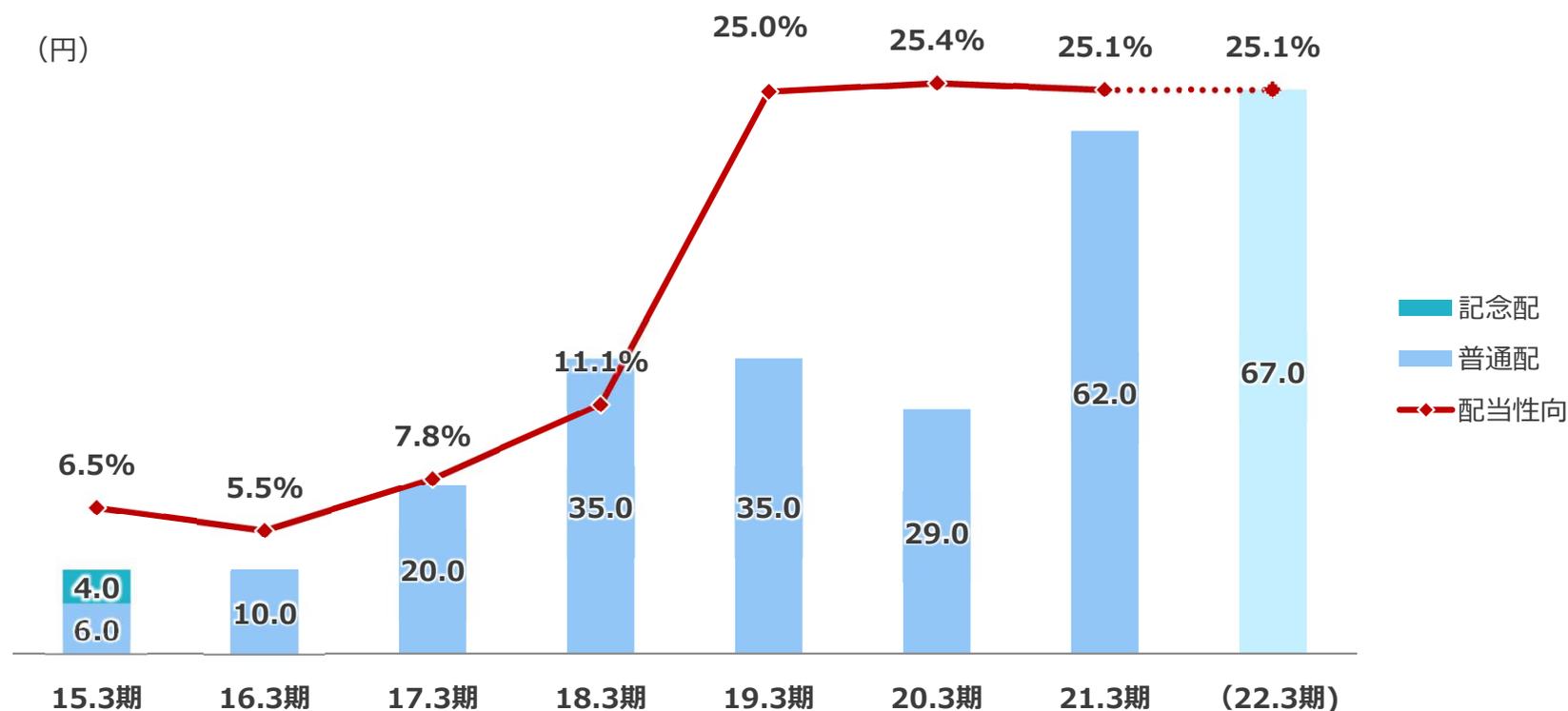


主要設備投資

- **21/3期**
 - ・内外テック 宮城物流センター 新棟増築 3.2億円
- **22/3期予定**
 - ・内外テック 宮城物流センター グループ物流の統合 1.7億円
 - ・内外エレクトロニクス 仙台事業所 クリーンルーム改築 3.3億円
- **今後の計画**
 - ・内外エレクトロニクス 東北地区 新工場新設
 - ・内外テック 製品自社開発のための開発リソース確保

連結配当性向25%程度を基準

- 2021年3月期の配当金は、期初予想を上回り上場来最高
- 2022年3月期の配当予想は、上場来最高の更新を見込む



(注) 配当金は、2016年10月1日付の株式併合2→1株を考慮して過去遡及した数値を記載。

(参考資料)

会社概要

会社概要

所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が2本柱
従業員数	連結 562名 (2021年3月末)
連結子会社	内外エレクトロニクス 株式会社 納宜伽機材 (上海) 商貿有限公司

内外テックの営業所・物流センター・開発センター ○
内外エレクトロニクスの事業所・サービスセンター(SC) ★

中国・上海



納宜伽機材 (上海)



半導体製造工程概要



5G対応のスマートフォンや基地局向け、自動車の自動運転向けなど半導体の需要増を背景に、前工程装置の設備投資の再拡大が見込まれる。

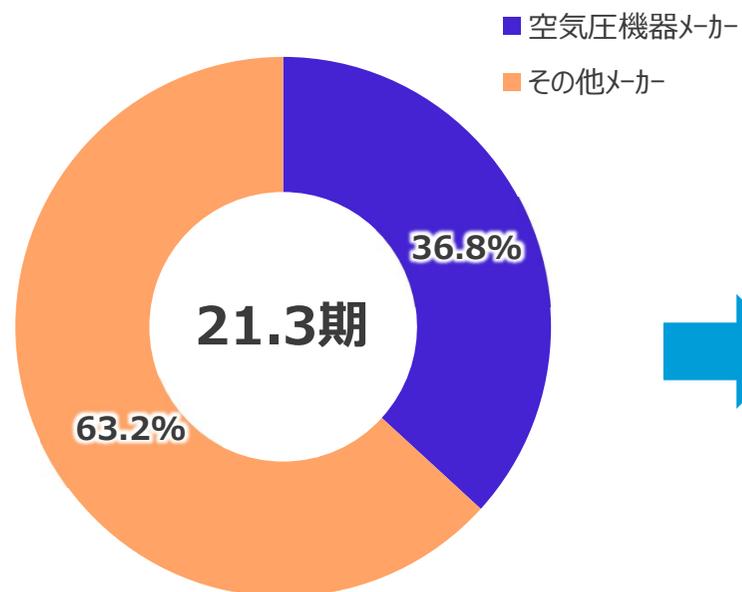
内外テック
技術提案商社

+

内外エレクトロニクス
受託製造メーカー

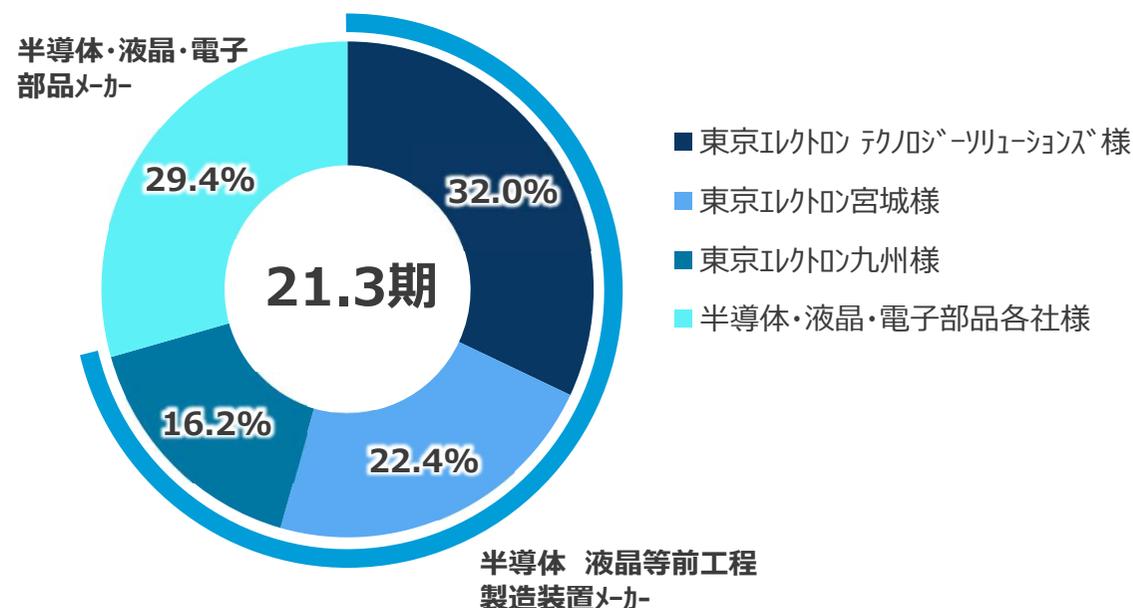
＝ モノづくりができるメーカー商社

【仕入先】



【販売先】

東京エレクトロン様グループで約7割



内外テック 仕入先・販売先

- 仕入先メーカー数 約1500社
 - 得意先数 約 950社
 - 主な取扱い商品サービス 空気圧機器、真空関連機器、機工部品、受託製造、保守メンテナンス、装置改造
- 年間取扱いアイテム 約58,000件

本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社